

## 出展申込書

マイクロウェーブ展2009事務局 行

—— 出展案内記載内容の全てを了承し、下記のとおり申込みます。——

ご出展社名 (フリガナ)	(印)		
英文社名			
ご住所	〒		
部署名			TEL: FAX:
ご担当者氏名	(印) E-mail		

出展小間料金	出展小間数	出展料
1 小間につき ¥ 441,000 (税込価格)	小間	円

※4小間以上のお申込み企業の小間装飾の高さ制限は4mまで緩和いたします。  
詳細は出展マニュアルに記載し、出展社説明会にて発表いたします。

<p><b>I 貴社の主な出展品目に該当する分野を下記1～4の中から一つだけお選び下さい。</b></p> <p>〔小間割、会場案内図作成の際に参考にさせていただきますので、複数分野を取扱われている場合でも、必ず、いずれか一つの方に絞り込んで下さい。詳しい内容は裏面の出展対象分野一覧をご参照願います。〕 ※番号を○で囲んで下さい。</p> <p>1. 材料・基板    2. 半導体素子・部品    3. 通信装置・コンポーネント    4. 測定装置・ソフトウェア</p>
<p><b>II 出展予定品目（商社の場合は取扱い出展予定会社）をご記入下さい。</b></p> <p>(なお、6月に作成予定のMWE 2009 アドバンス・プログラムには昨年度の出展社一覧を掲載させていただきます。)</p>

※小間割りは、全体のバランスを考慮して主催者側にて決定させていただきます。出展社からのご要望は一切受け付けいたしませんのでご了承願います。  
決定した小間割りは、9月10日頃にご通知させていただきます。

■申込先    マイクロウェーブ展 2009 事務局  
〒270-0034 松戸市新松戸1-409 新松戸Sビル3F  
FAX.047-309-3617    TEL.047-309-3616

■事務局記載欄

受 付			備 考
月	日	No.	

## ●出展対象分野一覧

### 1. 材料・基板

半導体ウェハー，誘電体・磁性体の材料・基板，積層基板，電波吸収体 等

### 2. 半導体素子・部品

シリコントランジスタ，化合物トランジスタ，WBGデバイス，MMIC・通信用LSI，ガンダイオード，光半導体素子，SAWデバイス，RF-MEMS，各種チップ受動部品，同軸ケーブル，コネクタ，セラミックパッケージ，マイクロ波管，VCO/DRO，E/O-O/Eコンバータ，ミキサ，スイッチ，フィルタ・共振器，デバイダ・カプラ，導波管コンポーネント，減衰器，終端器，フェライト部品 等

### 3. 通信装置・コンポーネント

WiMAX，UWB，無線LAN，RFID，Bluetooth，VSAT，ITS，衛星放送用LNB，携帯電話・PHS端末及び移動体衛星通信ターミナル，無線通信・放送用マイクロ波装置，基地局用増幅器・アンテナ，LMDS用ODU，ミリ波レーダ，各種通信用増幅器モジュール・高周波モジュール 等

### 4. 測定装置・ソフトウェア

ネットワークアナライザ，スペクトラムアナライザ，デジタル変調信号発生器，オシロスコープ，無線機テスタ，パワーメータ，各種自動測定システム，各種テストフィクスチャ，バイアスティー及びプローブ・プロービングシステム，アンテナ評価装置，電波暗室・シールドルーム，EMC評価装置，CAD・シミュレータ用各種ソフトウェア，プリント基板加工システム，各種実装装置 等

さらに上記項目に関連した書類・雑誌等の出版物